

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 3 月 1 日 (2007.3.1)

【公表番号】特表 2006-518943(P2006-518943A)

【公表日】平成 18 年 8 月 17 日 (2006.8.17)

【年通号数】公開・登録公報 2006-032

【出願番号】特願 2006-503859(P2006-503859)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

B 2 4 B 53/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 M

B 2 4 B 37/00 A

B 2 4 B 53/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 1 月 9 日 (2007.1.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ケミカルメカニカルプラナリゼーションに適した研磨パッドであって、
60%以上のパッド表面高さ比 R を有する表面高さ確率分布を特徴とする実質的に平坦な面を有する多孔性パッドコンディショナ表面を含む、研磨パッド。

【請求項 2】

R が 70%以上である、請求項 1 記載の研磨パッド。

【請求項 3】

ケミカルメカニカルプラナリゼーションに適した研磨パッドであって、
0.50 以下の非対称係数 A_{10} を有する非対称表面高さ確率分布を特徴とする多孔性パッドコンディショナ表面を含む、研磨パッド。

【請求項 4】

表面高さ確率分布が 60%以上のパッド表面高さ比 R を有する、請求項 3 記載の研磨パッド。

【請求項 5】

R が 70%以上である、請求項 4 記載の研磨パッド。